

# 第3回 有機/無機接合研究委員会 公開シンポジウム

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。下記の通り、第3回有機/無機接合研究委員会を公開シンポジウムとして開催いたします。

有機/無機接合研究委員会では、電子デバイス実装分野における樹脂材料を中心とする「接着界面現象・接着機構の明確化、信頼性評価方法」に関する有機/無機接合界面科学およびヘテロジニアス界面科学の構築を目的に学術的な議論を行っており、産官学で情報交換できる場を提供しています。

本シンポジウムでは、近年注目される金属とプラスチックの直接接合や新しい接合界面の解析手法、さらには実部品への適用事例など、最新の技術動向をトピックスとして集めております。公開シンポジウムにすることで、より広範の研究者・技術者の方と情報交換することができ、本分野のさらなる発展が期待できます。皆様のご参加をお待ち申し上げます。

**主催（一社）スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会**

**共催：（一社）エレクトロニクス実装学会(JIEP)**

**後援：（国研）産業技術総合研究所フレキシブルエレクトロニクス研究センター（依頼中）**

**開催日時：** 平成31年3月13日（水）13:00～16:50

**開催場所：** 拓殖大学 文京キャンパス E館 6F D会場（E608室）

〒112-8585 東京都文京区小日向3-4-14

**参加費：** 12,000円（主催共催後援団体会員、資料代含む）

その他の会員区分(JIEP会員区分、一般など)の参加費については以下のJIEP講演大会ホームページよりご確認ください。

※本参加費でJIEP講演大会(3/11～3/13開催)にも参加できます。

**申込方法：** 以下のJIEP講演大会ホームページよりお申込み下さい。

<https://web.jiep.or.jp/event/convention.html>

※有機/無機接合研究委員会会員の方で、委員会のみ参加の場合には、上記ホームページからのお申し込みは不要です。別途ご案内をお送りいたしますので、通常の手続きにてお申込みください。

**事前参加登録締切日：** 平成31年2月15日（金）

※当日の参加登録も受け付けていますが登録費が異なります。上記ホームページでご確認ください。

## プログラム

13:00～14:10	『マルチマテリアルに向けた異種材料接合技術及び国際標準化動向』(35分)	板橋 雅巳（大成プラス(株)）
	『異材接合体強度と破壊様式に及ぼす界面端形状の影響（仮）』(35分)	立野 昌義、徳元 黎一、村岡 俊輔（工学院大学）
14:10～14:20	休憩	
14:20～15:30	『隆起微細構造を用いた金属-プラスチック直接接合の可能性』(35分)	前田 知宏（輝創(株)）
	『有機/無機接合界面の分析手法』(35分)	泉 由貴子（(株)東レリサーチセンター）
15:30～15:40	休憩	
15:40～16:50	『転写印刷を利用した極薄MEMSのフィルム実装』(35分)	竹井 裕介（産業技術総合研究所）
	『導電性接着剤における有機/金属異相界面層の発達と導電性発現』(35分)	井上 雅博、根岸 智仁、中澤 史穂（群馬大学）